



非金属建材行业新材料研究

买入（维持评级）

 行业研究
 证券研究报告

建筑建材组

 分析师：李阳（执业 S1130524120003）
 liyang10@gjzq.com.cn

 分析师：赵铭（执业 S1130524120004）
 zhaoming@gjzq.com.cn

不谈织布机，电子纱供给、薄布需求是否支持电子布价格

G75 电子纱大涨，涨幅 61%紧跟电子布

受织布机紧张和 CCL 价格持续上行的催化，电子布价格上涨频次及幅度超预期，25Q4 以来 7628 电子布报价涨幅 78%（26 年 6 月时点价格为 7.4 元/米，25Q3 期末 4.15 元/米），其中 2-5 月每月跳涨 0.5 元/米、6 月跳涨 0.7 元/米。绝大部分电子布龙头企业为纱布一体化模式（电子纱为电子布原材料），但市场上同样存在少量电子纱外售进行代加工的商业模式、预计整体占比偏低。25Q4 以来 G75 电子纱（对应 7628 电子布上游）报价涨幅达 61%，26 年 6 月时点价格为 14525 元/吨，25Q3 期末 9000 元/吨。电子纱涨幅略低于布，但同样呈现逐月上涨趋势、且 3-6 月涨幅并未收窄，说明 G75 原丝库存同样紧缺。

普通电子布的结构化需求来自哪里①：AI 服务器混压带来大量薄布需求

PCB 混压是把不同种类的基材压合在一块板上，核心目的是在性能、可靠性和成本之间找到最佳平衡点，既能保证信号质量，又避免整板使用高价材料。我们预计 M8 方案是今年 AI 服务器高速信号层的核心高速材料，例如英伟达 Rubin 架构、google V8 等。M8 级别高速材料，PCB 混压方案在电源层预计大概率搭配 M4/M6 等相对低级别的高频材料，M4 及 M6 将带来大量薄布需求（low-dk 一代布目前主要应用于 M7 级别材料）。

聚焦在混压工艺对普通 E 布拉动的问题上，重视 2 个关键性结论：①PCB 板数量在增加，②AI 服务器对应 PCB 层数大规模增加。我们测算，仅 2025 年 AI 服务器混压工艺对薄布及以上 E 布需求拉动的比重在 3.8-7.7%，乐观预期下、2026 年拉动比例有望更高。

普通电子布的结构化需求来自哪里②：储能+新能源汽车结构化需求

（1）储能：25H2 以来海外储能需求持续超预期，预计 2026 年全球储能装机 438GWh、同比+62%，储能拉动高性能埋嵌 PCB 需求。

（2）新能源汽车电动化：新能源车电子化加速，车载 PCB 价值量翻倍。PCB 是新能源汽车三电控制的重要组成部分，新能源车单车 PCB 价值量达 1500-2000 元、是传统燃油车的 2 倍，其中 L2+自动驾驶域控制器需搭配 16 层 HDI 板，单车 PCB 价值量突破 5000 元。我们测算，2021-25 年我国汽车 PCB 板 CAGR 达 17.3%，主要驱动力为新能源汽车电动化需求、而非整体汽车销量。

如果电子纱供应持续偏紧，即使织布机到位，电子布是不是继续紧缺？

池窑和坩埚工艺均需要拉丝漏板，漏板由贵金属铂铑合金制作而成，贵金属价格上涨、导致行业成本大幅抬升。普通电子纱和 AI 电子纱对比，后者对拉丝漏板提出更高要求，但不影响电子纱漏板在做适当改造的情况下、转用于 AI 产线，漏板环节同样发生“AI 挤占”，企业有动力停产普通电子纱产线、设备调给 AI 产线。比贵金属更重要的、影响电子纱的供应因素是产业升级加快，企业更倾向投资 AI 电子纱而非普通电子纱。

投资建议与估值

我们继续看好普通电子布的涨价趋势，建议继续跟踪库存表现，以及观察薄布/超薄布/极薄布的应用空间，和织布机要素的变化、AI 挤占的状态。普通 7628 前次高点发生在 2021 年 8 月，对应价格约 8.75 元/米，当前价格在约为 7.5 元/米，距离前高仅为 18%。本轮供需边际变动仅反映 AI 赋能产业的开端，建议关注 AI 需求的超预期变化。

风险提示

算力需求不及预期；行业竞争格局恶化的风险；原材料价格波动的风险。



内容目录

1、普通电子布涨价归因，除织布机紧张外，电子纱也有紧缺	3
2、第一个视角，如果电子纱供应偏紧，即使织布机到位，电子布是不是继续紧缺？	4
3、第二个视角，普通电子布需求，比预期的更旺盛，原因在哪里？	4
3.1 E布同样用在AI服务器上	4
3.2 渗透率比总量更重要，新能源汽车、储能对E布是正向拉动	6
4、第三个视角，普通电子布正在进行产品升级，薄布/超薄布/极薄布接力	7
风险提示	8

图表目录

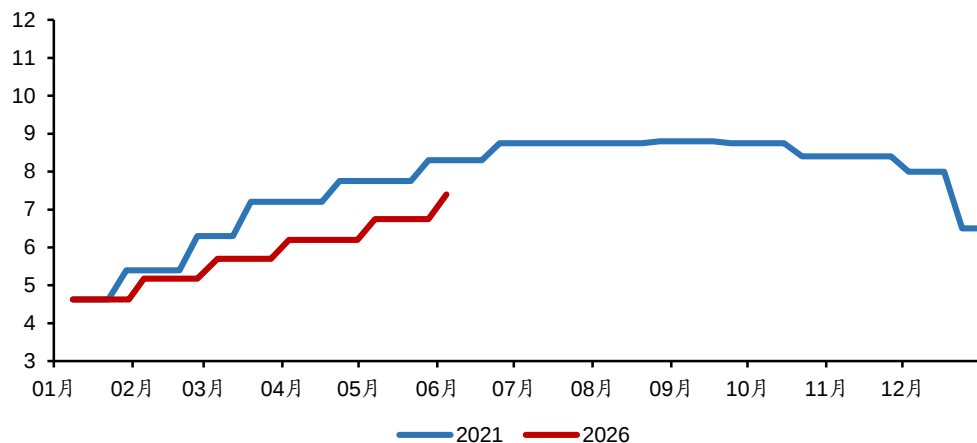
图表 1： 2025Q4 以来 7628 电子布报价累计涨幅达到 78%	3
图表 2： 电子布板块 2026Q1 业绩同环比普遍高增	3
图表 3： 2025Q4 以来 G75 电子纱报价累计涨幅达到 61%	3
图表 4： 铂金现价 487.38 元/g，同比+89%	4
图表 5： 铑现价 2410 元/g，同比+65%	4
图表 6： 电子纱紧缺同样是电子布紧缺的原因之一	4
图表 7： 不同损耗级别的 CCL 对应不同应用领域	5
图表 8： 英伟达 Rubin144-PCB 潜在的 PCB 架构设计图	6
图表 9： 2021-2025 年我国汽车 PCB 板 CAGR 达到 17.3%	6
图表 10： 预计 2026 年全球储能装机 438GWh、同比+62%	7
图表 11： M7 级别方案才开始大规模使用到 low-dk 一代布	7
图表 12： 仅 2025 年 AI 服务器混压工艺对薄布及以上 E 布需求拉动的比重在 4.5-9%	8
图表 13： 普通电子布的紧缺程度有 3 个因子共同决定	8



1、普通电子布涨价归因，除织布机紧张外，电子纱也有紧缺

最近半年，受织布机供应紧张和普通 CCL 持续涨价影响，电子布价格上涨频次及幅度超预期。2025Q4 以来 7628 电子布报价涨幅达 78%（2026 年 6 月时点价格为 7.4 元/米，25Q3 期末仅 4.15 元/米），其中 2-5 月每月跳涨 0.5 元/米、单月涨幅对应 10% 上下，6 月开始跳涨 0.7 元/米。2026 年一季度玻纤板块业绩表现亮眼，受益于①普通电子布涨价，②AI 需求驱动，中国巨石/中材科技/国际复材/宏和科技经营景气度突出、互为验证。

图表1：2025Q4 以来 7628 电子布报价累计涨幅达到 78%



来源：卓创资讯，国金证券研究所

图表2：电子布板块 2026Q1 业绩同环比普遍高增

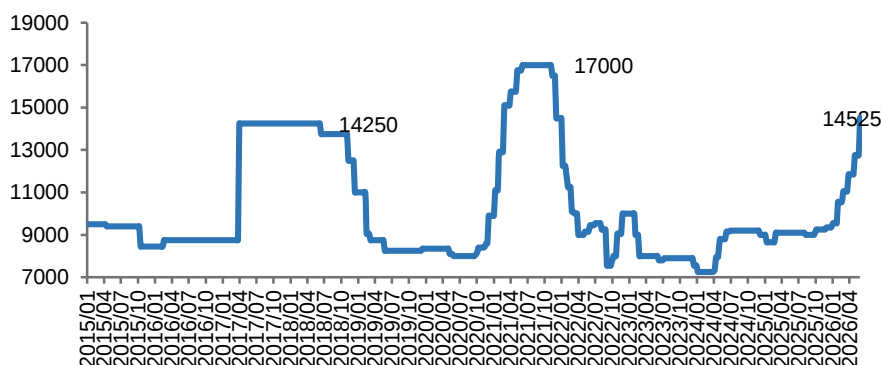
公司	单季度营业收入（亿元）				单季度归母净利润（亿元）			
	25Q4	26Q1	Q4 同比	Q1 同比	25Q4	26Q1	Q4 同比	Q1 同比
中国巨石	49.8	52.8	18%	18%	7.2	12.7	-21%	73%
中材科技	84.9	68.5	18%	24%	3.4	5.1	19%	40%
宏和科技	3.2	4.4	48%	80%	0.6	1.4	319%	354%
国际复材	22.4	22.1	14%	19%	0.0	2.7	100%	413%

来源：wind，国金证券研究所

作为电子布的原材料，电子纱的累计涨幅略低于布，但趋势一致。2025Q4 以来 G75 电子纱（对应 7628 电子布上游）报价累计涨幅 61%，2026 年 6 月时点价格为 14525 元/吨，2025Q3 期末仅 9000 元/吨。虽然电子纱同样逐月上涨，但累计涨幅略低于布（电子布同区间涨幅 78%）。

我们认为背后原因是，一方面外售电子纱偏少，因为行业龙头是一体化模式居多（电子纱是电子布的原材料），预计仅有少量企业外售纱，市场对纱的定价并未充分；另一方面，电子纱和布都很缺，并非缺布不缺纱（曾有一种逻辑推演是缺织布机后，不生产布导致电子纱堆积），从高频涨价推测出电子纱的库存同样偏低，但布的供应可能更紧张。

图表3：2025Q4 以来 G75 电子纱报价累计涨幅达到 61%





2、第一个视角，如果电子纱供应偏紧，即使织布机到位，电子布是不是继续紧缺？

谁在消化电子纱？电子纱的紧缺让我们提出一个可能性，假设未来织布机供应逐渐充足，因为缺原材料（电子纱），电子布仍然供应偏紧。我们尝试从国产织布机行不行、什么时候可以批量使用的问题中走出来，转而从电子纱的角度看待电子布价格的持续性。

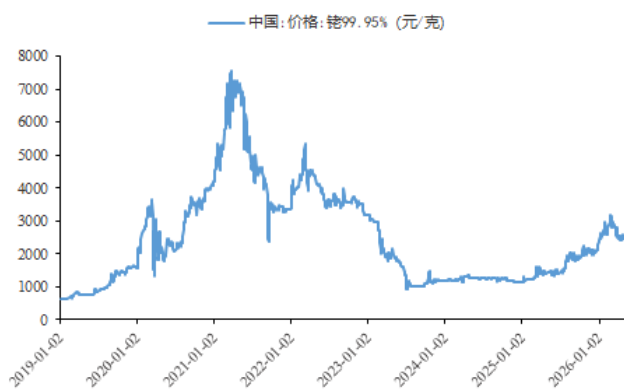
首先，池窑和坩埚工艺都需要拉丝漏板，漏板是关键的纤维成型装置、由贵金属铂铑合金制作而成，通常铂金占比 10%、铑粉占比 90%。贵金属铂、铑价格上涨，导致行业成本大幅抬升，主要体现在固定资产投资与生产损耗两方面：

- 新建产线投资增加，以粗纱为例（非电子纱，电子纱成本更高），一条 10 万吨粗纱产线，仅铂铑合金相关投入约 2 亿元，当前同类产线的贵金属投资已抬升至 4.5 亿元。我们预计因担心未来贵金属价格回落，企业普遍降低扩产意愿；
- 贵金属损耗成本上升，生产过程中一吨玻纤纱产品会永久带走 0.5-1g 铂金，从而形成贵金属损耗成本。

图表4：铂金现价 487.38 元/g，同比+89%



图表5：铑现价 2410 元/g，同比+65%



来源：wind，国金证券研究所

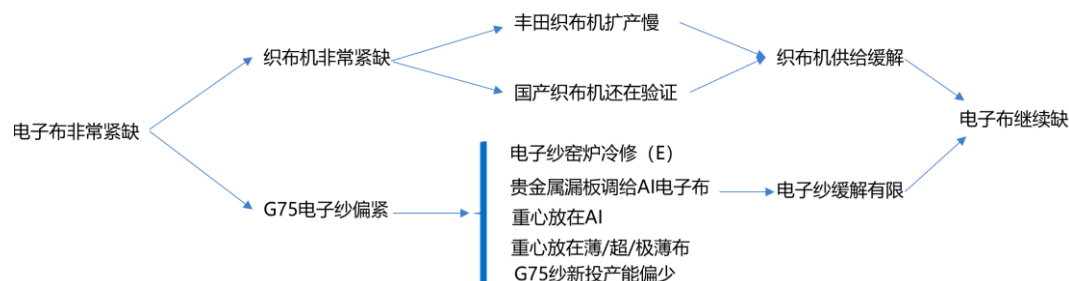
来源：wind，国金证券研究所

注：数据截至 2026 年 5 月 22 日，右图同

普通电子纱和 AI 电子纱对比，后者对拉丝漏板提出更高要求，例如不能剥离、用量更多，但不影响电子纱漏板在做适当改造的情况下、转用于 AI 产线，漏板环节同样发生“AI 挤占”，企业有动力停掉普通电子纱产线、设备调给 AI 产线。

但我们始终认为，贵金属更多影响资本开支落地的时间节奏、并不能真正阻碍投资，因为“贵并非买不到”，结合投资回报率和投资的必要性，过往无论是粗纱、电子纱，新增投产依然发生。**我们认为，比贵金属更重要的、影响电子纱的供应因素是产业升级加快，企业更倾向投资 AI 电子纱而非普通电子纱。**我们已知的公开转产企业包括境内的光远，中国台湾的台玻，日本的日东纺等。在贵金属价格高企的背景下、普通电子纱的贵金属漏板被更高阶产线挤占，导致电子纱的供应相对减少，此外，工业细纱也是下游需求的一个消化源。

图表6：电子纱紧缺同样是电子布紧缺的原因之一



来源：国金证券研究所

3、第二个视角，普通电子布需求，比预期的更旺盛，原因在哪里？

3.1 E 布同样用在 AI 服务器上

PCB 混压指的是将不同种类的基材(如高频材料以及普通

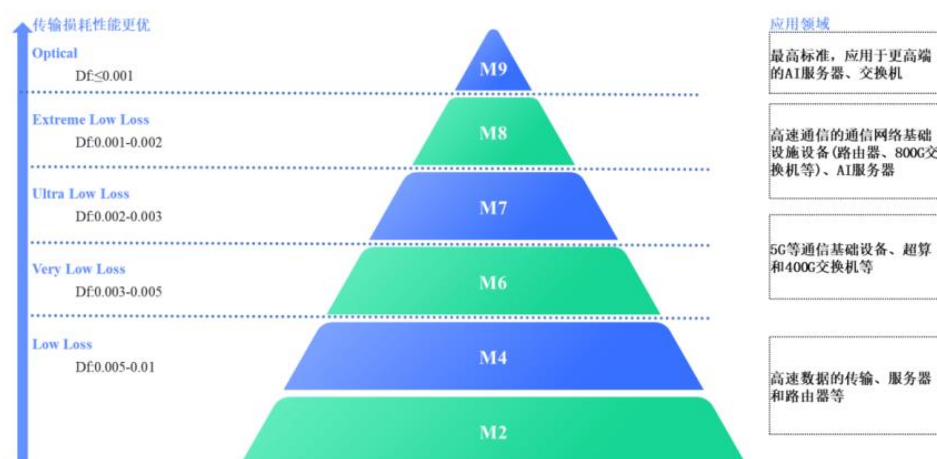


本之间找到最佳平衡点。混压情况下，在高速信号层使用低损耗 (Df)、低介电常数 (Dk) 且稳定的高频材料，其余层使用

松下电工 Megtron 系列为高速 CCL 领域分级标杆，其对于高速 CCL 等级分类为 M2 至 M9，其中 M9 为最高级别：

- M2、M4 级别 CCL 适用于高速数据传输、服务器和路由器等；
- M6 级别以上开始可用于 5G 等通信基础设施和超算，其 Df 值通常介于 3-5%；
- M7、M8 级别 CCL 损耗进一步降低，Df 值整体在 1-2%之间，为目前低传输损耗多层基板材料，其可用于高速通信的通信网络基础设施设备，是目前 AI 服务器、800G 交换机所使用的关键材料；
- M9 级别 CCL 为当前最高标准等级高频高速覆铜板，应用领域为高端 AI 服务器、交换机，如英伟达 GB300、Rubin 系列产品、1.6T 交换机等领域。

图表7：不同损耗级别的 CCL 对应不同应用领域



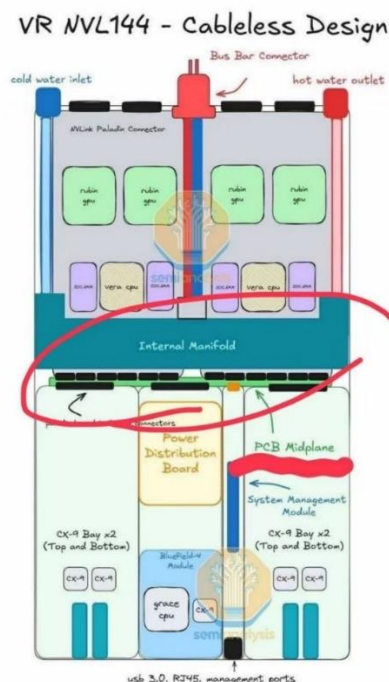
来源：中材科技公司公告，国金证券研究所

混压工艺对普通 E 布拉动的问题上，我们提示重视 2 个关键结论：①PCB 板数量在增加，②AI 服务器对应 PCB 层数大规模增加：

- ①PCB 板数量在增加，单机柜/GPU 对应 PCB 价值量在增加：以 2026 年推出的 Vera Rubin NVL144 CPX 为例，除已有的 computer tray 和 switch tray 外，新增 PCB 板主要为 Midplane，2027 年 Rubin Ultra 有望新增 PCB 板包括 LPU 以及正交背板；
- ②AI 服务器对应 PCB 层数大规模增加：技术上传统 8 卡 GPU 服务器 PCB 为 20-24 层，Rubin 架构为 40-78 层，LPU 预计采用 52 层 PCB 板、同时基材升级至 M9 等级，电子布消耗量大幅增加。



图表8：英伟达 Rubin144-PCB 潜在的 PCB 架构设计图



来源：Semi analysis, 国金证券研究所

3.2 渗透率比总量更重要，新能源汽车、储能对 E 布是正向拉动

首先，新能源车电子化加速，电路板渗透率提升，车载 PCB 价值量翻倍。PCB 是新能源汽车三电控制的重要组成部分，新能源车单车 PCB 价值量达 1500-2000 元、是传统燃油车的 2 倍，其中 L2+自动驾驶域控制器需搭配 16 层 HDI 板，单车 PCB 价值量突破 5000 元。我们测算，2021-2025 年我国汽车 PCB 板 CAGR 达到 17.3%，主要驱动力为新能源汽车电动化需求、而非整体汽车销量：

(1) 2025 年我国汽车总销量为 2374 万辆、较 2021 年增长 18%，其中，新能源汽车销量为 1649 万辆、较 2021 年增长 368%，新能源车渗透率由 2021 年的 18%提升至 2025 年的 69%。

(2) 参考“赣州市电子制造行业协会”微信公众号，此处假设 2025 年新能源车单车 PCB 价值量为 1750 元、燃油车单车 PCB 价值量为 875 元，以上数据较 2021 年略有增长。

(3) 测算 2025 年我国汽车 PCB 板市场空间达 352 亿元，较 2021 年增长 89%，CAGR 达 17.3%。

图表9：2021-2025 年我国汽车 PCB 板 CAGR 达到 17.3%

	2021		2025	
	燃油车	新能源汽车	燃油车	新能源汽车
我国销售量 (万辆)	1664	352	725	1649
单车 PCB 价值量 (元)	800	1500	875	1750
车用 PCB 市场空间 (亿元)	133	53	63	289
整体市场空间 (亿元)	186		352	
CAGR			17.31%	

来源：中汽协，“赣州市电子制造行业协会”微信公众号，国金证券研究所测算

第二，新型电力系统建设加速，储能变流器、电池管理系统 (BMS) 以及高压直流充电模块对功率模块的集成度、散热能力和长期可靠性提出严苛要求，高性能埋嵌 PCB 需求景气提升。



图表10: 预计 2026 年全球储能装机 438GWh、同比+62%

GWh	2023	2024	2025E	2026E
中国	46	110	150	250
yoy	203%	137%	37%	67%
美国	28	37	52	70
yoy	109%	34%	40%	35%
欧洲	17	22	33	51
yoy	95%	27%	51%	55%
其他	13	20	35	67
yoy	91%	58%	74%	91%
合计	104	189	270	438
yoy	136%	82%	43%	62%

来源: CNESA, Wood Mackenzie, EMME, 国金证券研究所

4、第三个视角，普通电子布正在进行产品升级，薄布/超薄布/极薄布接力

我们预计 M8 方案是今年 AI 服务器高速信号层的核心高速材料，例如英伟达 Rubin 架构、google V8 等。M8 级别高速材料，PCB 混压方案在电源层预计大概率搭配 M4/M6 等相对低级别的高频材料，M4 和 M6 将带来大量薄布需求（low-dk 一代布目前主要应用于 M7 级别材料、以及部分 M8 级别材料）。

图表11: M7 级别方案才开始大规模使用到 low-dk 一代布

产品名称	性能参数	对应覆铜板等级	直接客户情况
低介电纤维布	Dk4.4-4.6 Df0.0018-0.0026	M7	台光电子、台耀科技、斗山电子、生益科技等
超低损耗低介电纤维布	Dk3.7 Df0.0007	M8、M9	台光电子、斗山电子、松下集团等
低膨胀纤维布	CTE2.8-3.2	-	生益科技、力森诺科、三菱瓦斯等

来源: 中材科技公司公告, 国金证券研究所

我们测算，仅 2025 年 AI 服务器混压工艺对薄布及以上 E 布需求拉动的比重在 3.8-7.7%，乐观预期下、2026 年拉动比例有望达双位数：

(1) 2025 年中材科技特种玻纤出货量在 1917 万米，假设其全球市占率接近 20%，对应 2025 年全年特种玻纤出货量约 1 亿米。

(2) AI 服务器混压，我们假设 2 类情况，即高阶：低阶混压比例为 1:1 或者 2:1（采用 M8/M9 相对高级别的 CCL 材料层数：采用 M4/M6 相对低级别的 CCL 材料层数），则仅考虑 AI 服务器混压，2025 年有望拉动 E 布需求 0.5-1 亿米；

(3) 我们估计 2025 年全球普通电子布出货量在 37.2 亿米。根据玻璃纤维工业协会数据，2025 年我国电子纱产量 88.6 万吨，合理估计厚布克重 2.8g/cm²、厚布占比 70%，薄布克重 1.4g/cm²、厚布占比 30%，其中薄布及以上占比在 30%（参考巨石新线数据）、估计在 11.2 亿米；

(4) 以此测算，仅 2025 年 AI 服务器混压工艺对薄布及以上 E 布需求拉动的比重在 4.5-9%。

(5) AI 大规模拉动上游算力基建，2026 年全球云厂商资本支出上修至超 8000 亿美元、同比+67%，同时叠加高阶 PCB 层数增加，乐观预期下、2026 年拉动比例有望更多。

因此，我们可以定性推测，一方面需求结构化拉动下，普通电子布出货好于预期，另一方面，电子纱和织布机同时紧缺，上述 3 个因子①需求、②电子纱紧张、③织布机紧张的共同作用下，带来电子布的紧缺、从而提价，如果其中一个因素得到缓解，例如织布机加快供应（无论是海外还是国产），而另外两个因素不变，也不会完全改变电子布的紧张，普通电子布价格依然有上涨动力。我们接下来需要做的是，对 3 个因子的强弱保持持续跟踪。

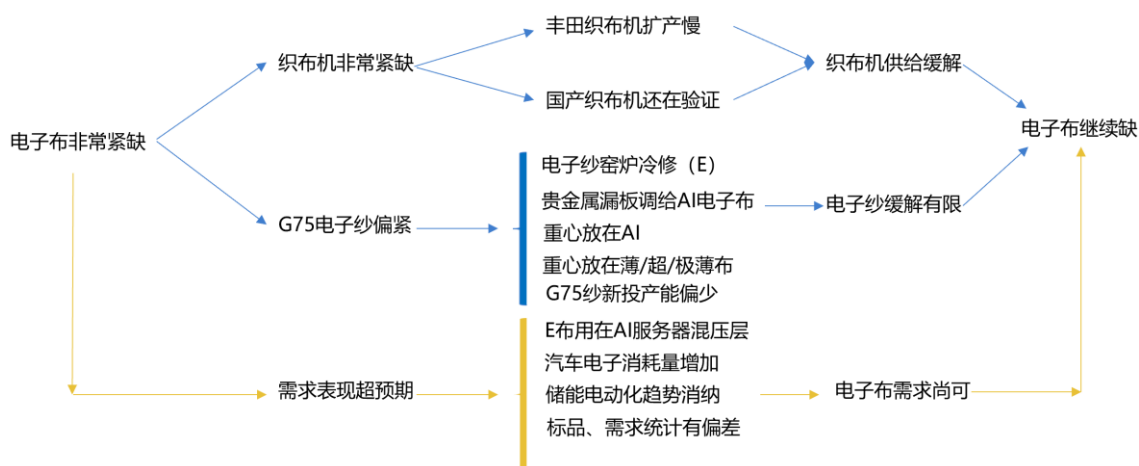


图表12：仅 2025 年 AI 服务器混压工艺对薄布及以上 E 布需求拉动的比重在 4.5-9%

	具体数据	
预估 2025 年全球特种玻纤出货量（亿米）	1	
假设 AI 服务器混压，高阶：低阶混压比例	1:1	2:1
混压工艺拉动薄布需求（亿米）	1.00	0.50
2025 年全球普通电子布出货量（亿米）	37.23	37.23
2025 年全球薄布及以上 E 布出货量（亿米）	11.17	11.17
AI 服务器混压工艺对薄布及以上 E 布需求拉动	8.95%	4.48%

来源：上海证券报，国金证券研究所测算

图表13：普通电子布的紧缺程度有 3 个因子共同决定



来源：国金证券研究所

投资建议：我们继续看好普通电子布的涨价趋势，建议继续跟踪库存表现，以及观察薄布/超薄布/极薄布的应用空间，和织布机要素的变化、AI 挤占的状态。普通 7628 前次高点发生在 2021 年 8 月，对应价格约 8.75 元/米，当前价格在约为 7.5 元/米，距离前高仅为 18%。本轮供需边际变动仅反映 AI 赋能产业的开端，建议关注 AI 需求的超预期变化。建议关注【中国巨石】【铜冠铜箔】【宏和科技】【芯基微装】【中材科技】【凯盛科技】【国际复材】【呈和科技】【联瑞新材】【德福科技】【莱特光电】【菲利华】【华正新材】【诺德股份】。

风险提示

算力需求不及预期：如果 AI 应用落地不及预期，导致海外大厂算力 CAPEX 不及预期，可能导致 PCB 需求量不及预期，进而导致以上 PCB 上游材料需求不及预期。

行业竞争格局恶化的风险：目前玻纤行业竞争格局较好，但后续如果有更多中国企业切入电子布领域，可能会导致行业竞争格局恶化，甚至出现价格下滑风险。

原材料价格波动的风险：电子布可变成本占比较高，原材料价格变化可能引起盈利能力波动。



行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海

电话：021-80234211

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 5 楼

北京

电话：010-85950438

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100005

地址：北京市东城区建国门内大街 26 号

新闻大厦 8 层南侧

深圳

电话：0755-86695353

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心

18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究